



意法半導體公布 2024 年第四季及全年財報

- 第四季營收 33.2 億美元，毛利率 37.7%，營業利益率 11.1%，淨利 3.41 億美元
- 全年營收 132.7 億美元，毛利率 39.3%，營業利益率 12.6%，淨利 15.6 億美元
- 營運展望（預測中位數）：預估第一季營收 25.1 億美元，毛利率 33.8%
- 啟動全球營運成本調整計畫 *

【臺北訊，2025 年 2 月 5 日】— 服務橫跨多重電子應用領域之全球半導體領導廠商意法半導體（STMicroelectronics，簡稱 ST；紐約證券交易所代碼：STM），公布依美國通用會計準則（U.S. GAAP）編製之截至 2024 年 12 月 31 日的第四季財報。

ST 第四季營收達 33.2 億美元，毛利率 37.7%，營業利益率 11.1%，淨利 3.41 億美元，稀釋後每股盈餘 37 美分。

意法半導體總裁暨執行長 Jean-Marc Chery 表示，2024 年全年營收為 132.7 億美元，較 2023 年減少 23.2%，營業利益率從前一年的 26.7% 降至 12.6%，淨利下滑 63.0% 至 15.6 億美元。公司在 2024 年投入 25.3 億美元於資本支出（非 U.S. GAAP），並產生 2.88 億美元的自由現金流。第四季營收符合財測中位數，個人電子產品業務成長帶動營收表現，但工業市場需求疲弱影響整體業績，汽車與通訊、電腦及周邊（CECP）業務則符合預期。第四季毛利率為 37.7%，與財測中位數接近。訂單出貨比（book-to-bill ratio）仍低於 1，反映工業市場復甦遲緩與存貨調整影響，歐洲汽車市場亦面臨放緩壓力。展望 2025 年，公司預估第一季營收為 25.1 億美元，年減 27.6%，季減 24.4%，毛利率約 33.8%，其中約 500 個基點的影響來自產能閒置成本。此外，公司計畫於 2025 年投入 20 億至 23 億美元於資本支出（淨資本支出，非 U.S. GAAP），以推動長期發展策略。

季度財務摘要

美國通用會計準則 (單位：百萬美元，除美股數據外)	2024 年 第四季	2024 年 第三季	2023 年 第四季	季增減率 (Q/Q)	年增減率 (Y/Y)
營收	\$3,321	\$3,251	\$4,282	2.2%	-22.4%
毛利	\$1,253	\$1,228	\$1,949	2.1%	-35.7%
毛利率	37.7%	37.8%	45.5%	-10 個基點	-780 個基點
營業利益	\$369	\$381	\$1,023	-3.3%	-64.0%
營業利益率	11.1%	11.7%	23.9%	-60 個基點	-1,280 個基點
淨利	\$341	\$351	\$1,076	-2.6%	-68.3%
稀釋後每股盈餘	\$0.37	\$0.37	\$1.14	0%	-67.5%

* 此計畫將依各國相關法規辦理並逐步推動。

意法半導體年度財務摘要

美國通用會計準則 (單位：百萬美元，除每股數據外)	2024 年	2023 年	年增減率 (Y/Y)
營收	\$13,269	\$17,286	-23.2%
毛利	\$5,220	\$8,287	-37.0%
毛利率	39.3%	47.9%	-860 個基點
營業利益	\$1,676	\$4,611	-63.7%
營業利益率	12.6%	26.7%	-1,410 個基點
淨利	\$1,557	\$4,211	-63.0%
稀釋後每股盈餘	\$1.66	\$4.46	-62.8%

2024 年第四季財報摘要

註：意法半導體於 2024 年 1 月 10 日 宣布全新組織架構，並自 2024 年第一季起調整業務部門的財報方式。過往年度比較數據已相應調整。

美國通用會計準則 (單位：百萬美元)	2024 年 第四季	2024 年 第三季	2023 年 第四季	季增減率 (Q/Q)	年增減率 (Y/Y)
類比、MEMS 與感測器 (AM&S) 事業群	1,198	1,185	1,418	1.1%	-15.5%
功率與分離式元件 (P&D) 事業群	752	807	965	-6.8%	-22.1%
類比、功率、離散元件、MEMS 與感測器 (APMS) 產品部門小計	1,950	1,992	2,383	-2.1%	-18.2%
微控制器 (MCU) 事業群	887	829	1,272	7.0%	-30.2%
數位 IC 與射頻產品 (D&RF) 事業群	481	426	623	13.0%	-22.8%
微控制器、數位 IC 與射頻產品 (MDRF) 產品部門小計	1,368	1,255	1,895	9.0%	-27.8%
其他	3	4	4	-	-
總營收	\$3,321	\$3,251	\$4,282	2.2%	-22.4%

意法半導體第四季營收為 33.2 億美元，年減 22.4%。其中，來自 OEM 與代理商的銷售分別減少 19.8% 和 28.7%。與前一季相比，營收成長 2.2%，符合公司財測中位數。

毛利為 12.5 億美元，年減 35.7%。毛利率為 37.7%，較財測中位數低 30 個基點，並較 2023 年同期下滑 780 個基點，主要受產品組合影響，此外，銷售價格與產能閒置成本的增加也對毛利率帶來一定程度的壓力。

營業利益為 3.69 億美元，較去年同期的 10.2 億美元大幅減少 64.0%。營業利益率為 11.1%，較 2023 年第四季的 23.9% 下滑 1,280 個基點。

相較去年同期各產品部門之表現：

類比、功率、離散元件、MEMS 與感測器 (APMS) 產品部門：

類比、MEMS 與感測器 (AM&S) 事業群：

- 營收年減 15.5%，主要受類比產品與影像感測業務下滑影響。
- 營業利益為 1.76 億美元，年減 41.2%，營業利益率為 14.7%，低於去年同期的 21.1%。

功率與離散元件 (P&D) 事業群

- 營收年減 22.1%。
- 營業利益下滑 63.7% 至 8,900 萬美元，營業利益率由 25.4% 降至 11.9%。

微控制器、數位 IC 與射頻產品 (MDRF) 產品部門：

微控制器 (MCU) 事業群

- 營收年減 30.2%，主要受通用型 MCU (GP MCU) 需求下滑影響。
- 營業利益為 1.27 億美元，年減 66.4%，營業利益率從 29.8% 降至 14.3%。

數位 IC 與射頻產品 (D&RF) 事業群：

- 營收年減 22.8%，主要因 ADAS (車用先進駕駛輔助系統) 及車載資訊娛樂系統業務下滑。
- 營業利益為 1.49 億美元，年減 33.2%，營業利益率從 35.7% 降至 31.0%。

淨利與稀釋後每股盈餘 (EPS) 分別降至 3.41 億美元與 37 美分，相較 2023 年同期的 10.8 億美元與 1.14 美元大幅下滑。值得注意的是，2023 年第四季的淨利包含一次性 1.91 億美元的非現金所得稅收益。

現金流與資產負債表重點

				過去 12 個月		
(單位：百萬美元)	2024 年 第四季	2024 年 第三季	2023 年 第四季	2024 年 第四季	2023 年 第四季	年變動
營運現金流 (淨額)	681	723	1,480	2,965	5,992	-50.5%
自由現金流 (非 U.S. GAAP)	128	136	652	288	1,774	-83.8%

第四季營運現金流為 6.81 億美元，較去年同期的 14.8 億美元大幅減少。2024 年全年營運現金流下降 50.5% 至 29.7 億美元，占全年總營收的 22.3%。

第四季資本支出 (淨資本支出，非 U.S. GAAP) 為 4.7 億美元，2024 年全年則達 25.3 億美元。相比之下，2023 年同期的淨資本支出分別為 7.98 億美元與 41.1 億美元。

第四季的自由現金流 (非 U.S. GAAP)，為 1.28 億美元，全年則為 2.88 億美元，較 2023 年同期的 6.52 億美元與 17.7 億美元大幅下滑。

第四季期末存貨為 27.9 億美元，較前一季的 28.8 億美元略降，但高於 2023 年同期的 27.0 億美元。期末存貨週轉天數為 122 天，較前一季的 130 天縮短，但高於去年同期的 104 天。

第四季期間，意法半導體向股東發放現金股利總計 8,800 萬美元，並根據現行的庫藏股回購計畫執行 9,200 萬美元的庫藏股買回。

截至 2024 年 12 月 31 日，公司淨財務狀況 (非 U.S. GAAP) 為 32.3 億美元，較 2024 年 9 月 28 日的 31.8 億美元增加，反映出總流動資金 61.8 億美元及總金融負債 29.5 億美元。若考量尚未用於資本支出的政府補助預付款對總流動資金的影响，經調整後的淨財務 (非 U.S. GAAP) 為 28.5 億美元。

企業發展動態

第四季，意法半導體宣布啟動全新的全球性計畫，以調整製造布局，推動晶圓廠產能升級，加速向 12 吋矽晶圓（Agrate、Crolles）及 8 吋碳化矽晶圓（Catania）轉型，同時優化全球成本結構。

該計畫預期將提升營運效率，進一步強化公司營收成長能力，並在 2027 年底前達成年節支出數億美元的目標。具體而言，在營運費用（SG&A 及研發支出），公司預計至 2027 年底，與 2024 年成本基準相比，每年可節省約 3 億至 3.6 億美元。

營運展望

意法半導體對 2025 年第一季的財測（中位數）預估如下：

- 營收預計為 25.1 億美元，較前一季減少 24.4%，變動幅度正負 350 個基點。
- 毛利率預計為 33.8%，變動幅度正負 200 個基點。
- 此預測假設 2025 年第一季歐元兌美元匯率約為 1 歐元兌 1.06 美元，並納入現有避險合約的影響。
- 2025 年第一季將於 3 月 29 日結束。

非 U.S. GAAP 財務資訊之使用原則

本新聞稿包含補充性的非 U.S. GAAP 財務資訊。

請注意，這些數據未經審計，亦非依據美國通用會計準則（U.S. GAAP）編製，不應視為 U.S. GAAP 財務指標的替代方案。此外，非 U.S. GAAP 財務指標可能無法與其他公司提供的類似數據直接比較。因此，這些資訊不應單獨解讀，而應結合意法半導體依據 U.S. GAAP 編製的合併財務報表來綜合參考。

關於非 U.S. GAAP 財務指標與 U.S. GAAP 財務指標的對應調整，請參閱本新聞稿附錄。

前瞻性資訊聲明

本新聞稿中部分非屬歷史事實的陳述屬於未來展望性聲明，包括符合 1933 年證券法第 27A 條或 1934 年證券交易法第 21E 條（經修訂）定義的前瞻性聲明。這些聲明依據管理層當前的觀點與假設，同時受到已知與未知風險及不確定因素的影響，可能導致實際結果、業績或發展情況與此類聲明所預期的情境產生重大差異，其中包括但不限於以下因素：

- 全球貿易政策變動，包括關稅與貿易壁壘的設立與擴大，可能影響整體經濟環境，進而對本公司產品需求產生不利影響；
- 宏觀經濟與產業趨勢的不確定性（如通膨及供應鏈波動），可能影響生產能力及終端市場對本公司產品的需求；
- 客戶需求與預測不符，可能導致本公司需採取調整措施，而相關轉型計畫可能無法完全或如預期發揮效益；
- 在技術快速變革的環境中，設計、製造與銷售創新產品的能力；
- 經濟、社會、公共衛生、勞動市場、政治或基礎建設環境的變化，包括宏觀經濟或區域事件、地緣政治與軍事衝突、社會動盪、勞資糾紛或恐怖活動，可能影響本公司、客戶及供應商的營運所在地；
- 突發事件或不可預見的情況，可能影響本公司執行計畫的能力，或影響獲得公共資金支持的研發與製造專案能否達成預期目標；
- 主要代理商出現財務困難，或主要客戶大幅縮減採購量，可能對本公司業務造成衝擊；
- 生產基地的產能利用率、產品組合與製造效能，以及履行與供應商或第三方代工廠預訂產能的需求量，皆可能影響營運表現；

- 設備、原材料、公用事業資源、第三方代工服務與技術等關鍵生產資源的可獲得性及成本，其中包括通膨導致的成本上升，可能影響公司運營；
- 資訊系統的功能與效能，該系統負責支援公司核心業務，包括製造、財務與銷售，且面臨網路安全威脅，任何公司內部或客戶、供應商、合作夥伴及第三方技術供應商系統的資安漏洞都可能帶來風險；
- 員工、客戶或其他第三方的個人數據遭竊、遺失或遭濫用，以及違反數據隱私法規的風險；
- 競爭對手或其他第三方對本公司智慧財產權（IP）提出的主張，以及本公司能否在合理條件下取得必要授權；
- 全球稅務規範變動的影響，包括稅務法規的修訂、新法案的頒布、稅務稽查結果或國際稅收協定的變更，這些因素可能影響本公司的營運成果，以及準確估算稅收抵減、優惠、扣除額與準備金的能力，並可能影響遞延所得稅資產的可實現性；
- 外匯市場波動，特別是美元兌歐元及其他主要營運貨幣的匯率變動，可能影響財務表現；
- 現有訴訟的結果及任何潛在新訴訟的影響，可能對公司造成財務或營運風險；
- 產品責任或保固索賠，包括因產品瑕疵、交付延遲或流行性缺陷所引發的索賠，以及客戶對內含本公司零組件產品的召回行動，可能帶來法律及財務負擔；
- 自然災害及不可抗力事件，如極端氣候、地震、海嘯、火山爆發或其他天災，以及氣候變遷影響、健康風險、傳染病或全球疫情，這些因素可能影響本公司、客戶或供應商的營運所在地；
- 產業內法規日益嚴格與相關政策推動，包括氣候變遷與永續發展相關規範，以及本公司於 2027 年達成範疇 1 和範疇 2 碳中和、部分涵蓋範疇 3 的目標；
- 疫情對全球經濟的長期影響，可能造成市場疲弱，進而對本公司的業務及營運成果帶來重大不利影響；
- 產業變動，包括供應商、競爭對手與客戶之間的垂直與水平整合，可能影響市場競爭與供應鏈穩定性；
- 新專案的量產進度，可能因超出本公司控制範圍的因素受到影響，例如關鍵第三方零組件的供應狀況及外包商能否符合預期的生產表現。

此類前瞻性聲明涉及各種風險與不確定因素，可能導致本公司業務的實際結果與表現與預測內容存在重大落差，甚至產生不利影響。部分前瞻性聲明可透過特定詞彙加以識別，例如**「認為」（believes）、「預期」（expects）、「可能」（may）、「預計」（are expected to）、「應該」（should）、「將會」（would be）、「尋求」（seeks）或「預測」（anticipates），以及類似表達方式或其否定詞、變化形式，或涉及策略、計畫與意圖的敘述。

部分風險因素已詳載於本公司提交至美國證券交易委員會（SEC）的 2023 年度 20-F 表格年報中，請參閱「項目 3：關鍵資訊 — 風險因素」章節（2024 年 2 月 22 日提交）。若上述風險或不確定因素發生，或基礎假設與預期不符，實際結果可能與本新聞稿中預測、認為或期待的情境產生重大差異。

本公司無意亦無義務對本新聞稿所述的產業資訊或前瞻性聲明進行更新，以反映後續事件或市場變化。

關於意法半導體

意法半導體擁有超過 50,000 名專業人才，憑藉先進的製造技術與完整的供應鏈管理，致力於推動半導體產業發展。作為垂直整合製造商（IDM），我們與超過 20 萬家客戶及數千家合作夥伴攜手合作，共同研發產品、解決方案與生態系統，協助客戶掌握商機並因應技術挑戰，同時推動更永續的發展。我們的技術廣泛應用於智慧交通、更高效的電力與能源管理，以及物聯網與連網技術的普及，為各行各業提供關鍵技術支援。此外，我們承諾在 2027 年達成範疇 1 和範疇 2 的碳中和目標，並逐步減少範疇 3 的碳排放。欲了解更多資訊，請造訪 www.st.com。